



REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA

---

## COMUNICADO DE PRENSA

---

### **La Comisión pone en marcha la Empresa Común de Chips en el marco de la Ley Europea de Chips**

Bruselas, 1 de diciembre de 2023

La Comisión inauguró ayer oficialmente la [Empresa Común de Chips](#), que reforzará el ecosistema europeo de semiconductores y el liderazgo tecnológico de Europa. Colmará la brecha entre la investigación, la innovación y la producción, facilitando así la comercialización de ideas innovadoras. La Empresa Común de Chips desarrollará, entre otras cosas, líneas piloto para las que la Comisión anunció ayer la primera convocatoria, dotada con **1 670 millones de euros** de financiación de la UE, que se espera vayan acompañados de fondos de los Estados miembros hasta alcanzar los **3 300 millones de euros**, a los que se añadirá financiación privada.

Además, ayer celebró su primera reunión el **Consejo Europeo de Semiconductores**, el cual reúne a los Estados miembros para asesorar a la Comisión sobre la aplicación coherente de la [Ley Europea de Chips](#) y la colaboración internacional en materia de semiconductores. Constituirá la plataforma clave para la coordinación entre la Comisión, los Estados miembros y las partes interesadas para abordar las cuestiones relacionadas con la resiliencia de la cadena de suministro y las posibles respuestas a las crisis.

#### **La Empresa Común de Chips**

La Empresa Común de Chips es la principal ejecutora de la [iniciativa Chips para Europa](#) (presupuesto total previsto de 15 800 millones de euros hasta 2030). La Empresa Común de Chips tiene por objeto reforzar el ecosistema de semiconductores y la seguridad económica de Europa mediante la gestión de un

presupuesto previsto de casi 11 000 millones de euros de aquí a 2030, proporcionado por la UE y los Estados participantes.

La Empresa Común de Chips:

- establecerá líneas piloto precomerciales e innovadoras, que proporcionen instalaciones de vanguardia de la industria para ensayar, experimentar y validar tecnologías de semiconductores y conceptos de diseño de sistemas;
- desarrollará una plataforma de diseño basada en la nube para las empresas de diseño en toda la UE;
- apoyará el desarrollo de capacidades tecnológicas y de ingeniería avanzadas para chips cuánticos;
- creará una red de centros de competencia y promoverá el desarrollo de capacidades.

La actividad de la Empresa Común de Chips refuerza el liderazgo tecnológico de Europa al facilitar la transferencia de conocimientos del laboratorio a la fábrica, reduciendo la brecha entre la investigación y la innovación y las actividades industriales, y al fomentar la comercialización de tecnologías innovadoras por parte de la industria europea, incluidas las pymes.

### **Primeras convocatorias de financiación de líneas piloto de chips**

Para poner en marcha sus primeras convocatorias de líneas piloto innovadoras, la Empresa Común de Chips ofrecerá **1 670 millones de euros de financiación de la UE**. Las convocatorias están abiertas a las organizaciones que deseen establecer líneas piloto en los Estados miembros, por lo general organizaciones de investigación y tecnología, convocándose propuestas sobre los temas siguientes:

- **Silicio sobre aislante completamente agotado, en camino a los 7 nm:** Esta arquitectura de transistor es una innovación europea y presenta ventajas claras para aplicaciones de alta velocidad y eficientes desde el punto de vista energético. Una hoja de ruta en camino a los 7 nm proporcionará la senda hacia la próxima generación de dispositivos semiconductores de alto rendimiento y bajo consumo.
- **Nodos de vanguardia por debajo de 2 nm:** Esta línea piloto se centrará en el desarrollo de tecnologías de vanguardia para semiconductores avanzados de tamaño igual o inferior a 2 nanómetros, que desempeñarán funciones esenciales en diversas aplicaciones, desde la computación hasta los dispositivos de comunicación, los sistemas de transporte y las infraestructuras críticas.

- **Integración y montaje de sistemas heterogéneos:** La integración de sistemas heterogéneos es una tecnología cada vez más atractiva para la innovación y el aumento del rendimiento. Se refiere al uso de tecnologías avanzadas de encapsulado y técnicas novedosas para combinar materiales, circuitos o componentes semiconductores en un único sistema compacto.

- **Semiconductores de banda ancha:** La atención se centrará en los materiales que permiten que los dispositivos electrónicos funcionen a una tensión, frecuencia y temperatura mucho más elevadas que los dispositivos estándar basados en silicio. Los semiconductores de banda ancha y ultraancho son necesarios para desarrollar dispositivos electrónicos de radiofrecuencia con una potencia muy eficiente, un peso más ligero y unos costes más bajos.

El plazo para las convocatorias de estas líneas piloto finaliza a principios de marzo de 2024. [Aquí](#) podrá obtenerse más información sobre el proceso de solicitud de estas convocatorias y las líneas piloto que van a desarrollarse.

## Contexto

La presidenta de la Comisión, Ursula **von der Leyen**, anunció por primera vez una estrategia europea común para el sector de los semiconductores en su [discurso sobre el estado de la Unión de 2021](#). En febrero de 2022, la [Comisión propuso la Ley Europea de Chips](#). En abril de 2023, el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE alcanzaron un [acuerdo político](#) sobre la Ley de Chips. La [Ley de Chips entró en vigor](#) el 21 de septiembre de 2023 y, con ella, el Reglamento sobre la [Empresa Común de Chips](#) y el Consejo Europeo de Semiconductores.

## Más información

[Ley Europea de Chips](#)

[Ley Europea de Chips - Preguntas y respuestas](#)

[Ley Europea de Chips: Página de información en línea](#)

[Ley Europea de Chips: Ficha informativa](#)

[Propuesta de la Comisión de una Ley Europea de Chips](#)

[Comunicación sobre la Ley Europea de Chips](#)

## Cita(s)

*Celebro con gran satisfacción la puesta en marcha de la Empresa Común de Chips y las nuevas líneas piloto para semiconductores. No podemos cumplir los objetivos de nuestra Década Digital sin las tecnologías fundamentales en las que se basa nuestra sociedad digital. Nuestra transición a un futuro más ecológico y digital depende de nuestro acceso a los semiconductores y de nuestro liderazgo con respecto a estos.*

**Věra Jourová, vicepresidenta responsable de Valores y Transparencia - 30/11/2023**

*Con ya 100 000 millones de euros invertidos en semiconductores europeos, la Ley de Chips de la UE está plenamente en acción. Ahora, con la puesta en marcha de la Empresa Común de Chips y las líneas piloto, damos un paso audaz para impulsar nuestra industria de semiconductores. En un mundo de perturbaciones de la cadena de suministro y tensiones geopolíticas, Europa está tomando en sus propias manos su destino tecnológico e industrial.*

**Thierry Breton, comisario responsable de Mercado Interior - 30/11/2023**

## **Contactos para los medios de comunicación**

**Johannes BAHRKE**

### **Teléfono**

+32 2 295 86 15

### **Correo**

[johannes.bahrke@ec.europa.eu](mailto:johannes.bahrke@ec.europa.eu)

**Thomas Regnier**

### **Teléfono**

+32 2 29 9 1099

### **Correo**

[thomas.regnier@ec.europa.eu](mailto:thomas.regnier@ec.europa.eu)

Si no trabajas para un medio de comunicación, puedes dirigirte a la UE a través de Europe Direct, ya sea por [escrito](#) o llamando al 00 800 6 7 8 9 10 11.

IP/23/6167

---

**Contacto:** [Equipo de prensa](#) de la Comisión Europea en España

También puedes encontrarnos en:



<http://ec.europa.eu/spain>



[@prensaCE](#) y [@comisioneuropea](#)



[@comisioneuropea](#)



[@comisioneuropea](#)



[/EspacioEuropa](#)



[RSS](#)